TAZMO

タツモ株式会社
決算説明資料

2025年12月期第1四半期

2025年5月14日

証券コード　6266

会社案内ダウンロード

https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/tazmo_companyguide.pdf

INDEX
目次

1. 2025年12月期第1四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

1

2025年12月期第1四半期 連結業績

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2025年12月期第1四半期　決算ハイライト

TAZMO

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
7,516百万円	1,210百万円	1,176百万円	855百万円
前年比 +27.3%	前年比 +112.2%	前年比 +77.7%	前年比 +101.3%

■ 概況

- 前期比では増収増益。計画比では売上高は概ね計画通り、利益は上振れる結果となった。プロセス機器事業で検収遅れが発生しているが、表面処理用機器事業では堅調に進んだ。
- 受注状況は、搬送機器は引続き堅調で半導体装置は概ね想定内。他の事業では引合はあるものの受注は遅延傾向にある。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2025年12月期第1四半期 連結業績

TAZMO

(百万円)	2024年12月期 Q1 実績	2025年12月期 Q1		前期比増減率(%)	2025年12月期 計画	進捗率(%)
		実績	売上比(%)			
売上高	5,905	7,516	―	27.3	41,000	18.3
売上総利益	1,883	2,606	34.7	38.4	―	―
営業利益	570	1,210	16.1	112.3	5,000	24.2
経常利益	662	1,176	15.7	77.6	5,100	23.1
親会社株主に帰属する当期純利益	425	855	11.4	101.2	3,500	24.4

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

連結売上高・連結営業利益推移

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

連結貸借対照表

（百万円）	2024年12月期	2025年12月期Q1	前期比増減
流動資産	40,731	40,391	△340
固定資産	8,469	8,677	208
有形固定資産	7,385	7,537	152
無形固定資産	156	167	11
投資その他資産	927	971	44
総資産合計	**49,200**	**49,068**	**△132**
流動負債	17,696	17,624	△72
固定負債	6,861	7,363	502
負債合計	**24,557**	**24,988**	**431**
純資産合計	**24,642**	**24,080**	**△562**
自己資本比率	49.1%	48.2%	△0.9P

主な増減要因

流動資産

現金及び預金	△216
受取手形及び売掛金	＋756
電子記録債権	△948
棚卸資産	＋440
その他	△377

流動負債

電子記録債務	△1,849
短期借入金	＋298
契約負債	＋2,337
未払法人税等	△768

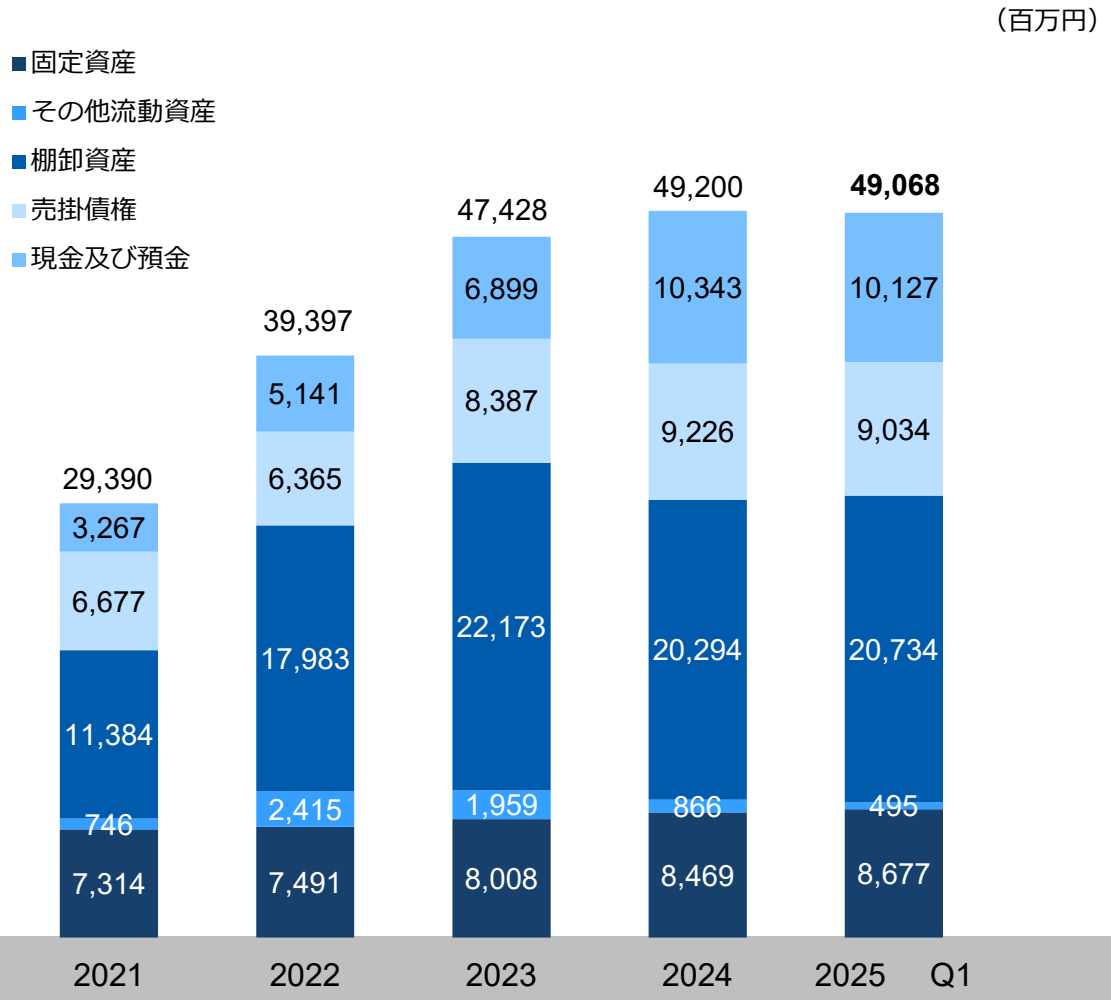
固定負債

長期借入金	+543

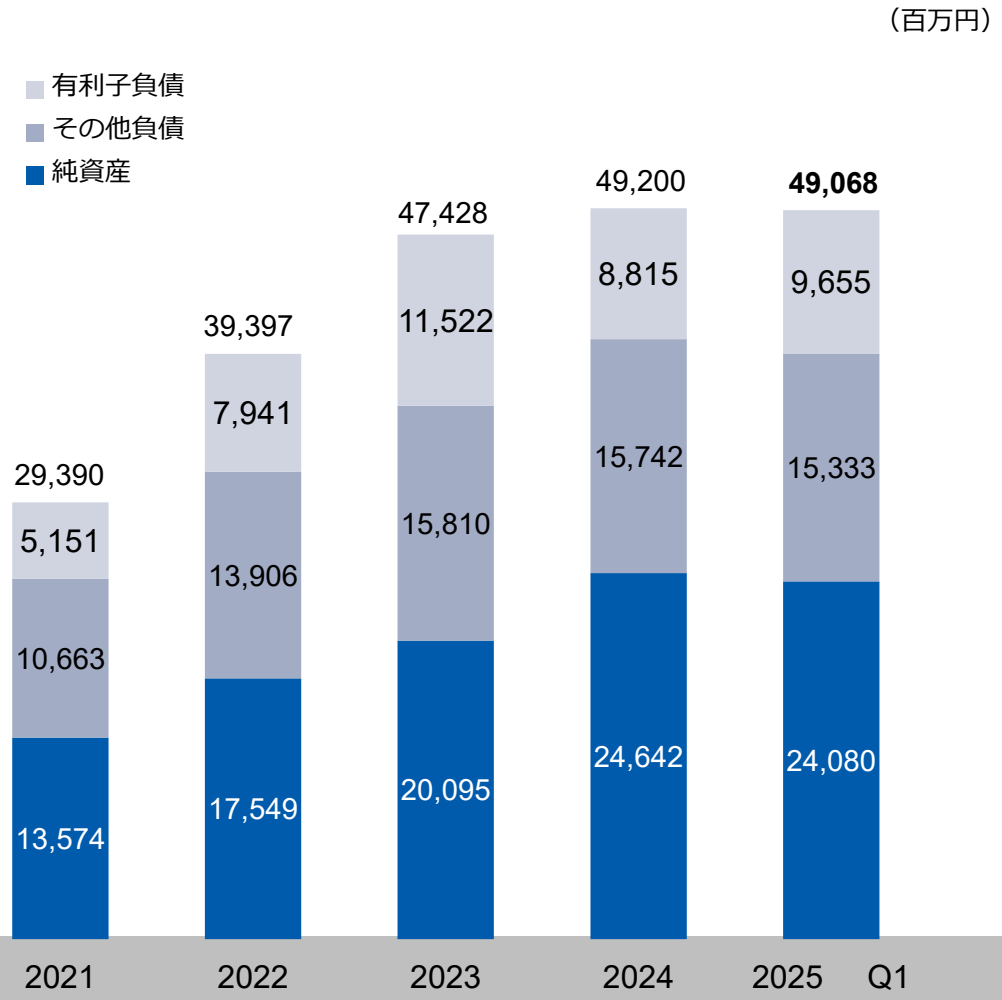
© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

資産・負債／純資産推移

資産



負債／純資産



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2 セグメント別業績

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

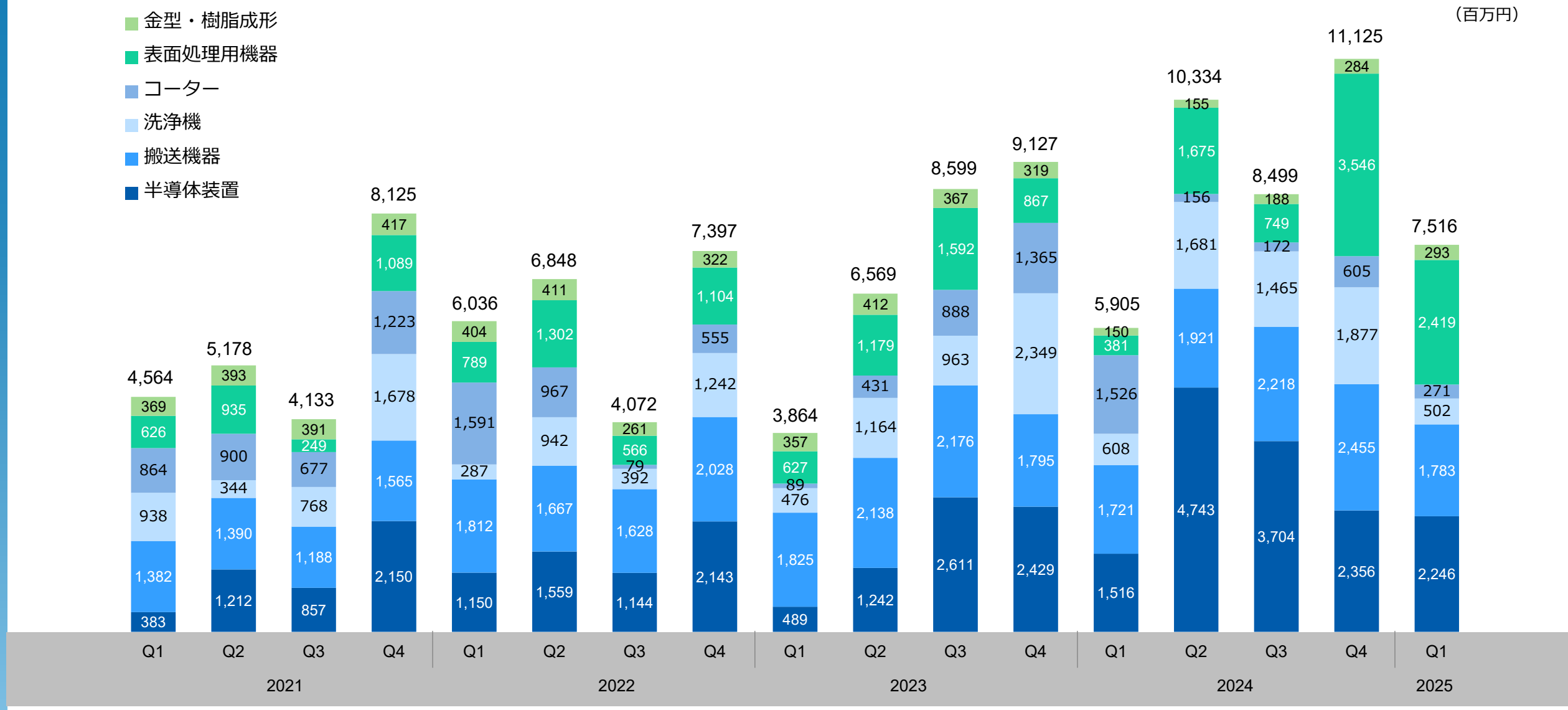
2025年12月期第1四半期　セグメント別業績

TAZMO

		(百万円)	2024年12月期 Q1 実績	2025年12月期 Q1 実績	前期比 増減率(%)	2025年12月期 計画	進捗率(%)
プロセス機器事業	売上高		5,374	4,803	△10.6	33,000	14.6
	営業利益		730	752	3.0	4,500	16.7
■ 半導体装置	売上高		1,516	2,246	48.1	18,200	12.3
■ 搬送機器	売上高		1,721	1,783	3.6	9,300	19.2
■ 洗浄機	売上高		608	502	△17.4	3,700	13.6
■ コーター	売上高		1,526	271	△82.2	1,800	15.0
金型・樹脂成形事業	売上高		150	293	95.3	1,100	26.6
	営業利益		△52	38	―	50	76.0
表面処理用機器事業	売上高		381	2,419	534.7	6,900	35.1
	営業利益		△131	394	―	450	87.6
セグメント間連結消去	営業利益		△83	△95	―	―	―
合計	売上高		5,905	7,516	27.3	41,000	18.3
	営業利益		570	1,210	112.2	5,000	24.2

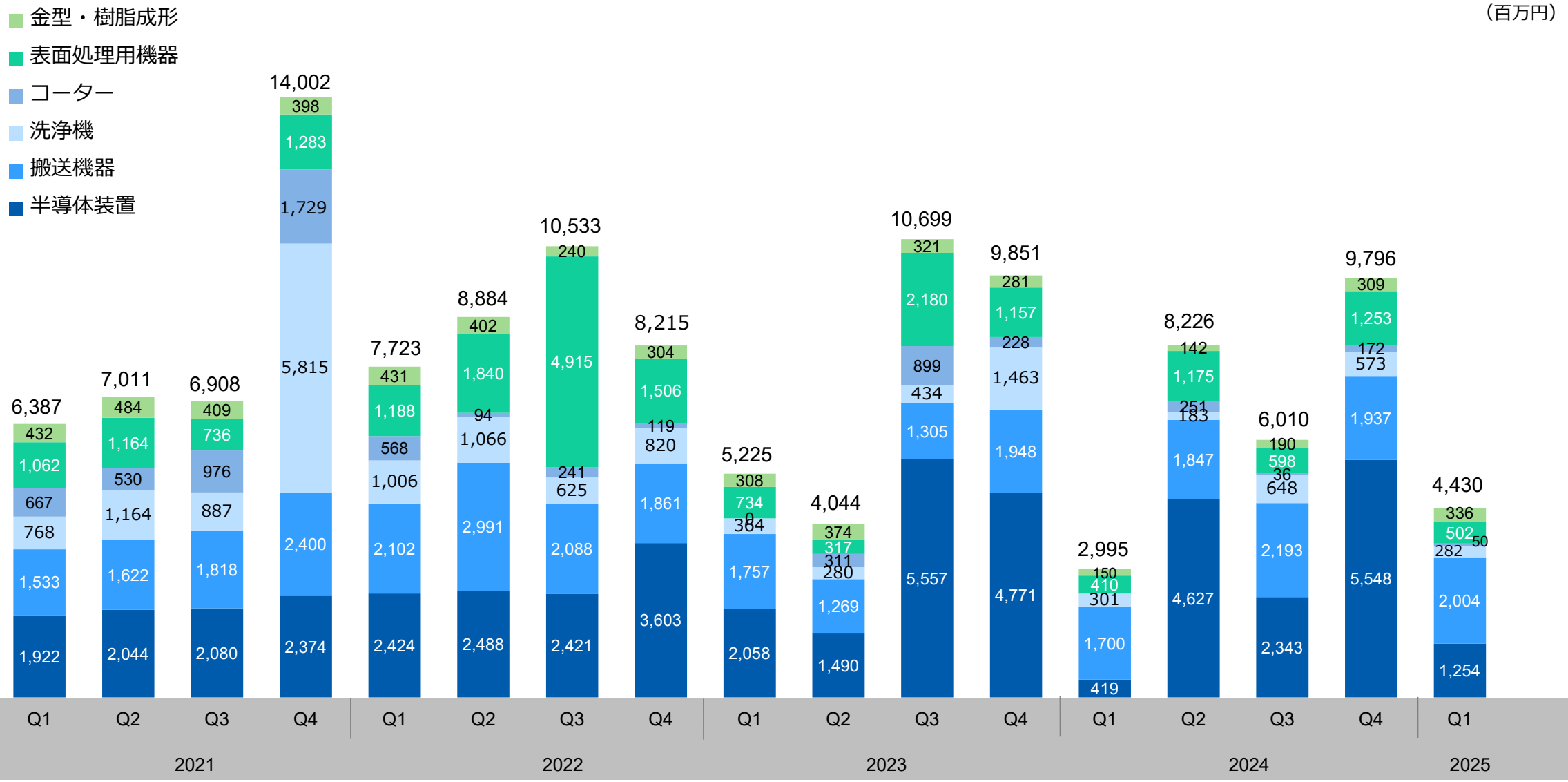
© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　売上高推移



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

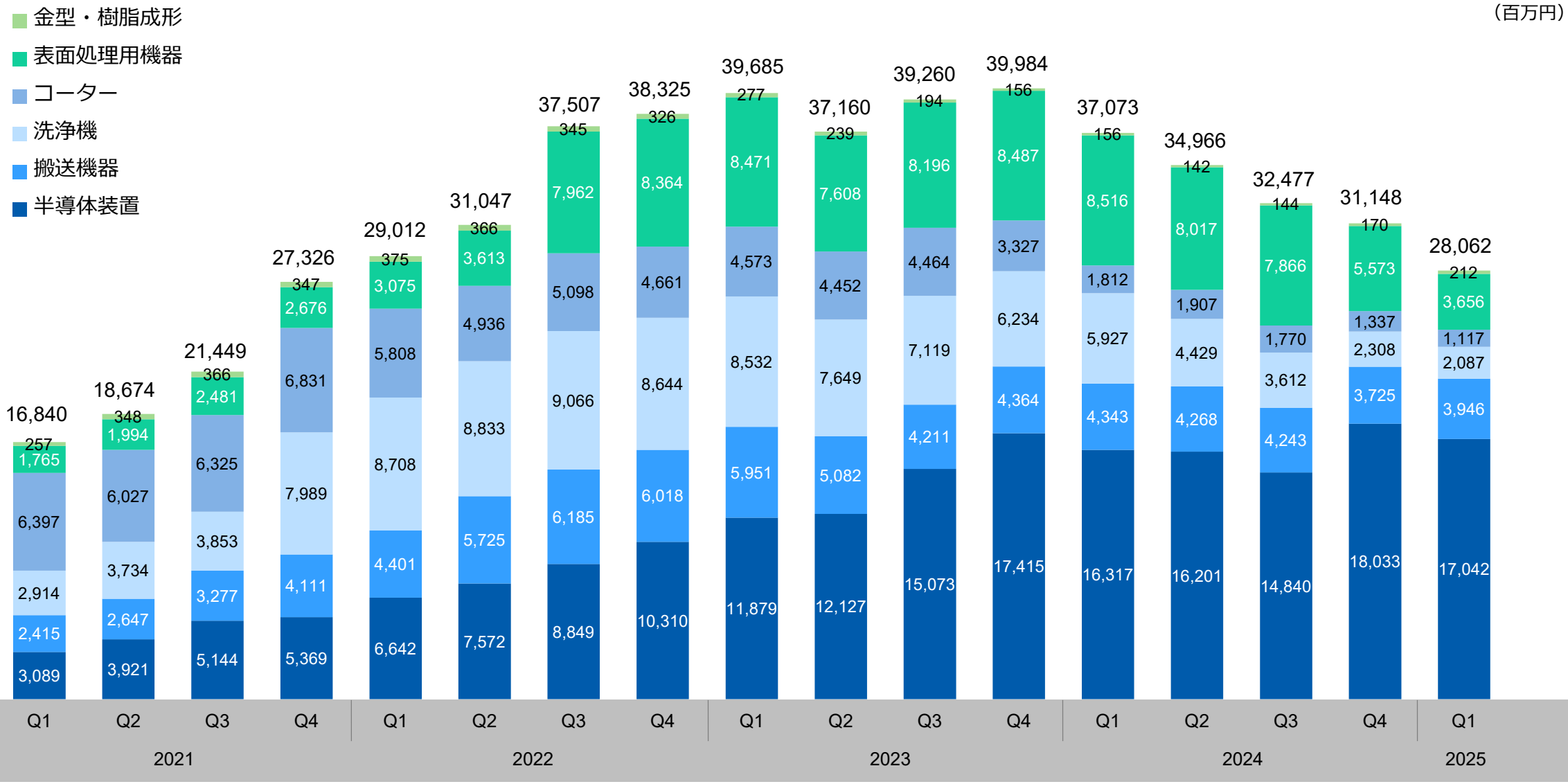
セグメント別　受注高推移



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　受注残高推移

TAZMO



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

3 市場（顧客）の状況

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

市場（顧客）の状況

TAZMO

- 半導体製造装置は、アドバンスドパッケージについては引合案件を１Qでは受注に至らなかったが、タイミングの問題と考えている。パワー半導体向け装置では2026年以降の投資に向けた引合いが出てきているが受注にはもう少し時間がかかりそう。

- 搬送機器ではメモリー／ロジックの市場状況の影響がまだ残っているが、徐々にではあるが回復傾向にあるが、国別の受注状況は月毎にばらつきがある。

- スラリー供給装置の引合いはあるもののユーザーの投資判断に時間がかかっている。確実に受注できるよう対応中。洗浄装置では、少しずつ新規案件の話が出てきているが投資時期は2026年以降。

- PLP装置では、台湾などで引合あり。確実に受注できるよう対応中。今後の市場の拡大を期待している。

- 表面処理用機器は引合いはあるものの、投資時期が2026年後半以降の案件が多く受注には時間がかかりそう。遅延していた基板搬送関連は納入が進んでいる。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

4 補足資料

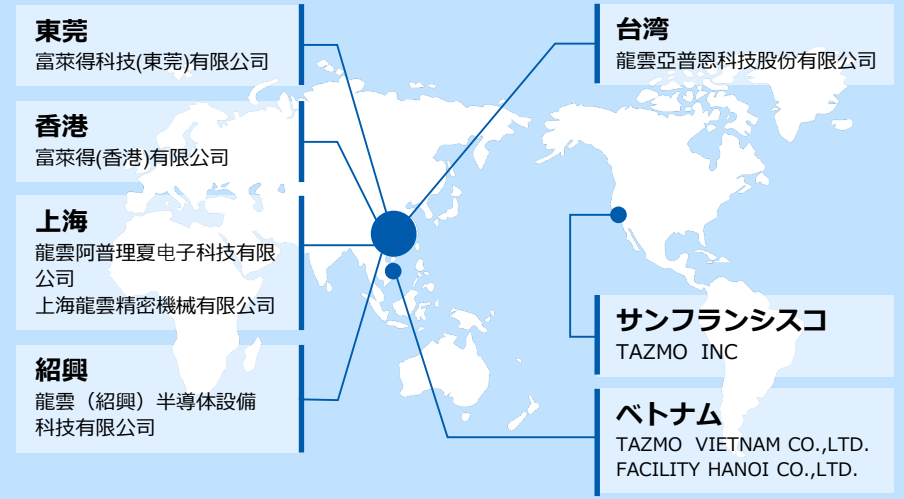
© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

会社概要

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	8,903名（2024年12月31日現在）
従業員数	単体 414名／連結 1,163名（2024年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

国内拠点・関連子会社

海外拠点



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

沿革

TAZMO

1972
- 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立

1980
- インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始

1989
- 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

1990
- 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始

1994
- エンボスキャリアテープの製造・販売を開始

1995
- インジェクション成形品の製造・販売を開始

2001
- 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、
- 製造・販売を開始

2004
- JASDAQ市場に株式を上場

2008
- TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009
- 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

2013
- アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築

2017
- 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化

2018
- 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2019
- 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

2020
- アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

2022
- 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

事業概要

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供

搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディーさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供

洗浄装置事業

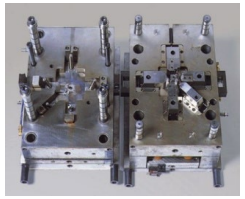
半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供

コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フラットパネル製造装置を提供。現在はPLP用装置やナノインプリント装置の開発を進めている。

金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

本資料の取扱上の注意

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的をしたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社　経営企画室

086-239-5000

086-239-5100

keiki@tazmo.co.jp